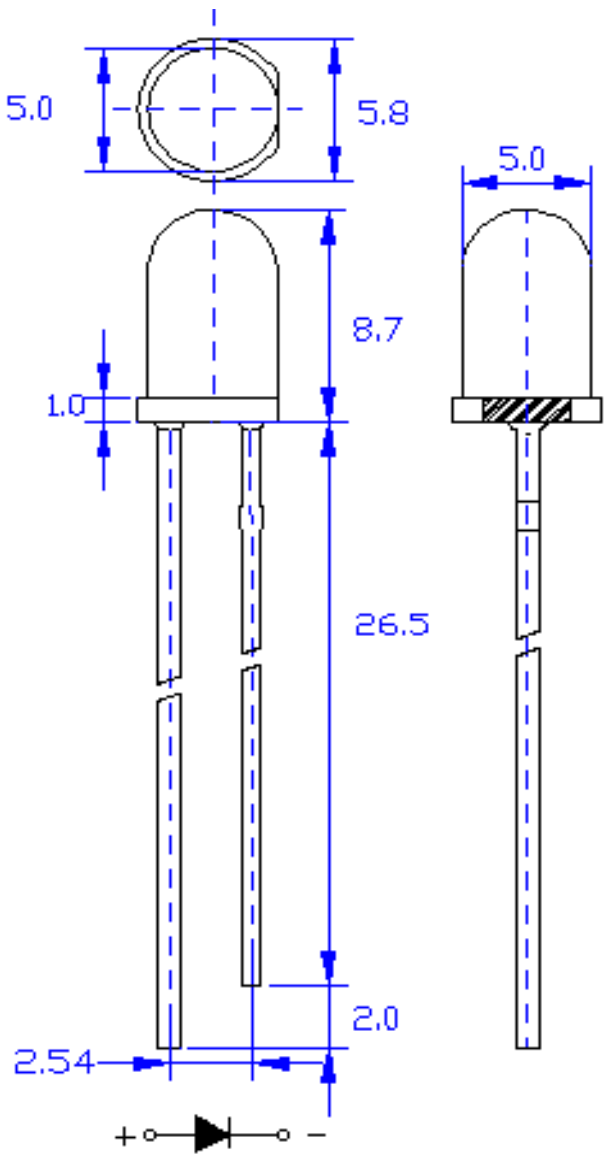


Package Dimensions:



Lens	Material	Emitting Color
Water Clear	GaAs	infrared

- 备注:
- 1. 单位: mm
 - 2. 未注明公差为正负0.25毫米0.010英寸
 - 3. 多出胶体最大为1.0毫米
 - 4. 规格修改将不预先通知

最大参数值及温度=25℃

参数	极限参数	单位
功耗	100	mW
脉冲电流	60	mA
顺向直流电	30	mA
反向电压	6	V
工作温度	—55℃ to+100℃	
贮藏温度	—55℃ to+100℃	
焊接温度	260℃ for 3 seconds	

光电特性参数及温度=25℃

参数	符号	小	标准	大	单位	测试条件
发光角度	2 θ 1/2		30		deg	IF=20mA
发光距离	L	12		15	m	
峰值波长	λ p		940		nm	IF=20mA
正向电压	VF	0.9		1.3	V	IF=20mA
反向电流	IR			5	μ A	VR=5V

备注:

1. 此发光亮度为根据人眼对发光亮度之感应曲线之模拟发光强度符合CIE（国际光委会组织）
2. 此发光角度之测量为其发光亮度一半时所测试之数据
3. 发光亮度保证误差正负15%

使用说明书

1. 应用

此LED可使用于一些普通的电子设备，例如办公设备，通信设备、房屋装饰，若LED用在一些可靠性要求较高的情况下，如航空运输，交通控制及医辽器械时，一定需参考销售提供之资料进行使用。

2. 贮存

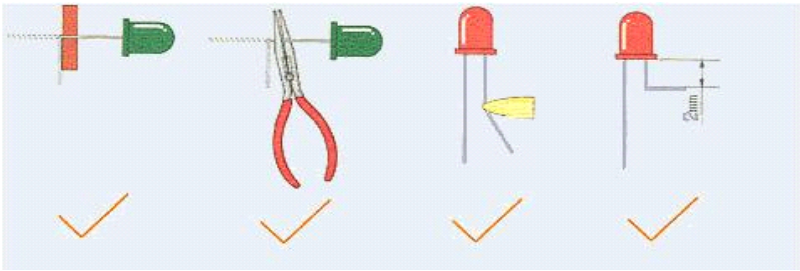
贮存LED的环境，温度不超过30℃，相对湿度不超过70%。 建议LDE在原包装箱里日期不超过三个月进行使用，如果需加长贮存时间，建议放在干燥箱内，并加放干燥剂， 或者充入氮气。

3. 清洗

当用化学品清洗胶体时必须特别小心，因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍，时间在常温下不超过3分钟。

4. 引脚装配

- 1）必需离胶体2毫米才能折弯支架。
- （2）支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
- （3）支架成形必须在焊接前完成。
- （4）支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
- （5）焊接必须在正常温度下进行，当LED正常焊接到PCB板上后，应尽量避免在LED引脚处施加机械压力



5. 焊接

当焊接时，必需在胶体底部2mm以下进行焊接，在焊接时，应尽力避免浸渍LED胶体，在刚焊接完后，应避免在引脚上加外力或者摇动LED胶体。

推荐的焊接条件

烙铁焊接		波峰焊	
温度	260℃ Max	Pre-heat	100℃ Max
焊接时间	5 sec.Max	Pre-heat time	60sec.Max
	(one time only)	Solder wave	260℃ Max
		Soldering time	10sec.Max

过高的焊接温度和长时间的焊接会导致LED变形和失效

6. 驱动方式

LED的当前驱动方式

若LED为多颗并联时，建议采用线路A，在每颗LED，处加一限流电阻，以保证LED之亮度一致。



五、静电防护

静电和电流的急剧升高将会对LED产生损害，InGaN系列产品使用时请使用防静电装置，如防护带和手套
注意：使用时人体放电模式HBM<1000V；机器放电模式<100V。